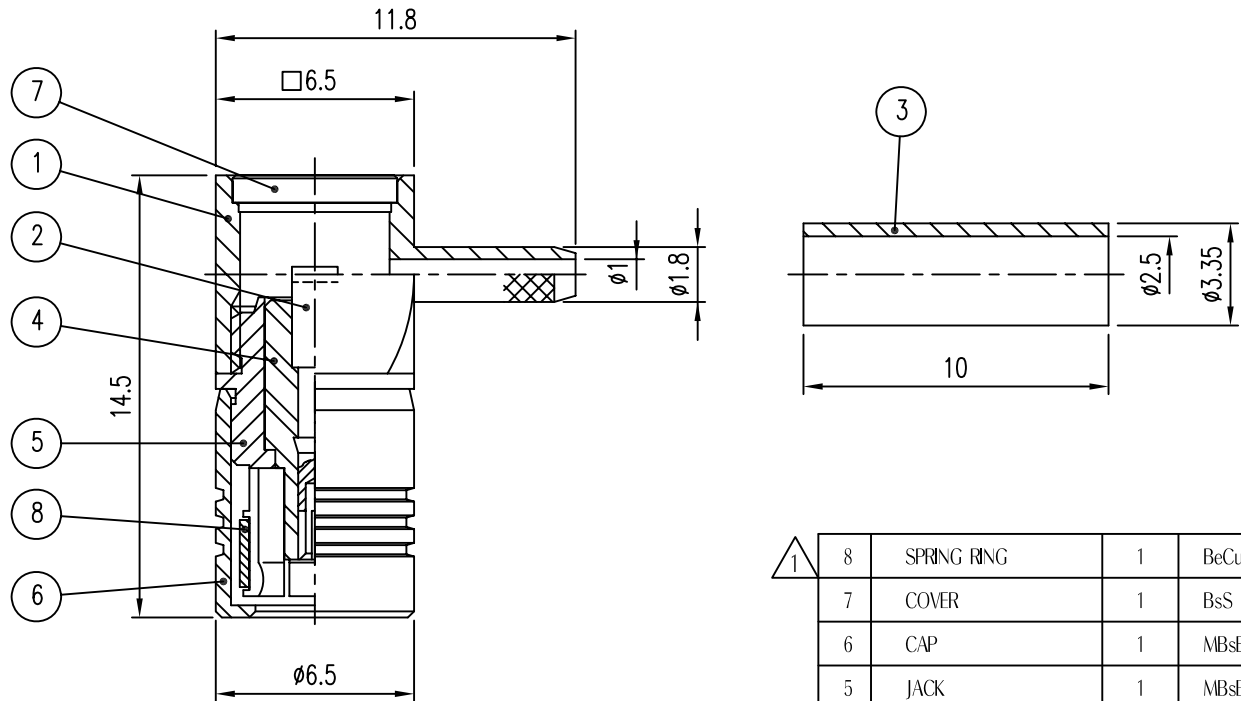


수 정 내 용									
ST	개량								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	표준화(Mating 부분)를 위한 SPRING RING 변경 (실변No.연구2005-105) R3003->3001로 변경 삽입력/이탈력 도면에 기입	김인철	유일환	2005. 5. 3.					
2	[실변No.202201-0009] DIE 부착 후 BURR 발생 개선으로 인한 DIE 변경	은선영	김선호	2022. 1. 18.					



1	8	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
	7	COVER	1	BsS	Gold Plate	DCO00036-15/1 (L3010)
	6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00023-135/1 (K3004)
	5	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00034-135/1 (J3014)
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00342-N/1 (H3012)
2	3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DIE00018-5/2 DIE00018-145/1 (E3012)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00359-1345/1 (E3008)
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00449-135/1 (D3011)

- 주 기
- △1. 상대물과 삽입력과 이탈력
- 삽입력 : 6.5kgf 이하
 - 이탈력 : 5± 2kgf

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2002. 1. 26.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
	재질	검도			도명 SMB-LPC-178	
열처리	재도					
보호피막처리	작성부서		연 구 소	A4	도번 CN00205-7/1 K315-142-000	
	적도 5/1	단위 mm				중량